

关键指标

- 频率：0.4~2GHz
- 增益：20dB
- 噪声系数：0.4dB
- 1dB 压缩点输出功率：22.5dBm
- 电压/电流：+5V/65mA
- 外形尺寸：2mm×2mm×0.8mm

产品简介

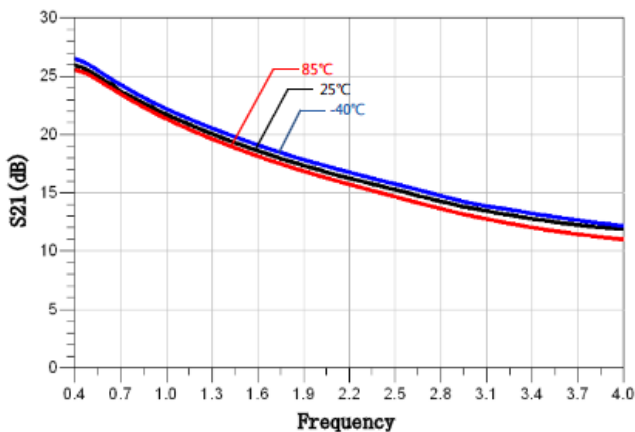
HG113F5-PQ2A 是一款 2mm×2mmDFN 表贴塑封达林顿放大器芯片，增益为 20dB，噪声系数 0.4dB，1dB 压缩点输出功率 22.5dBm，按照推荐装配图使用，+5V 供电端需外加扼流电感，输入输出端需外加隔直电容。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V)

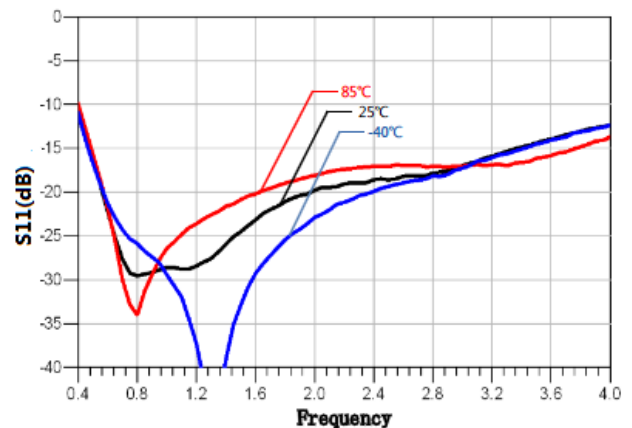
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.4~2		
增益(dB)	—	20	—
输入回波损耗(dB)	—	20	—
输出回波损耗(dB)	—	12	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	22.5	—
OIP3(dBm)	—	35	—
噪声系数 (dB)	—	0.4	—
静态电流 (mA)	—	65	—

典型测试曲线

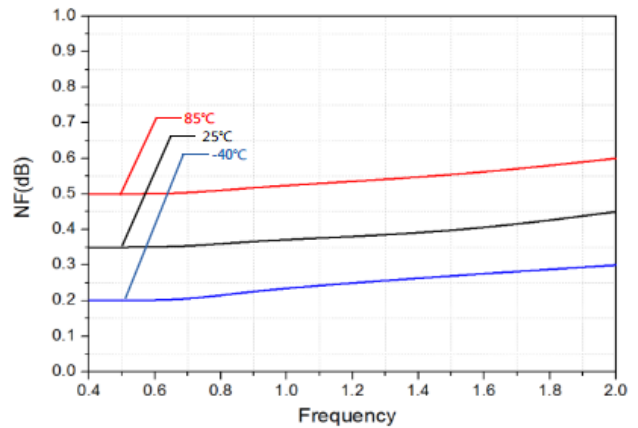
增益



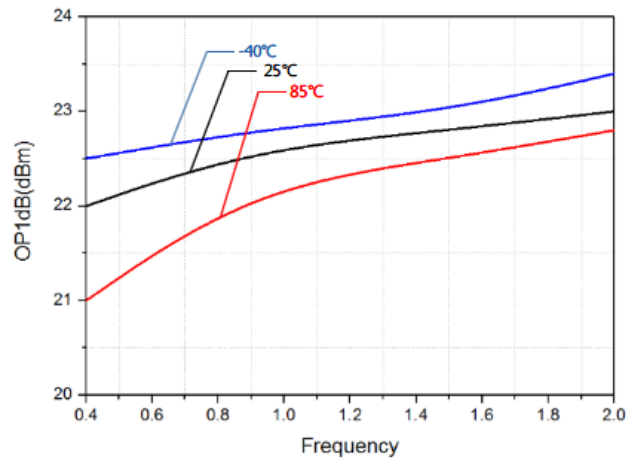
输入回波损耗



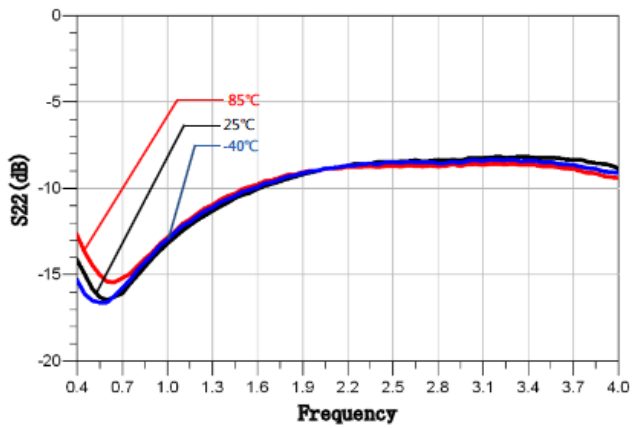
噪声系数



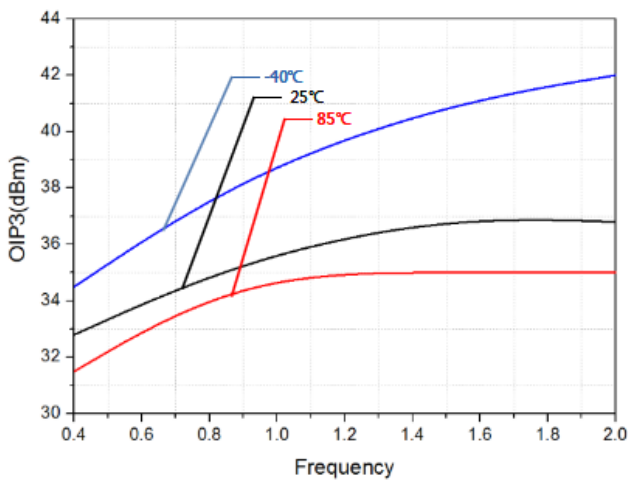
1dB 压缩点输出功率



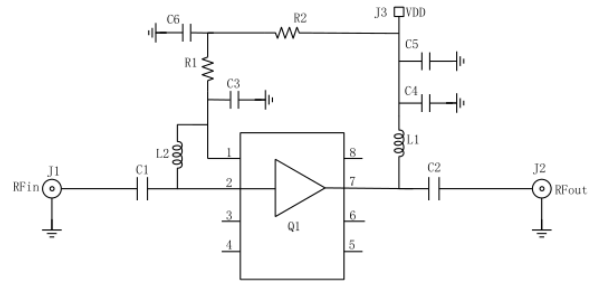
输出回波损耗



OIP3



推荐装配图



标志	推荐值
C1、C2	100pF
C3、C4、C6	100pF
C5	0.1uF
L1	47nH
L2	18nH
R1	51 Ω
R2	6.5K Ω

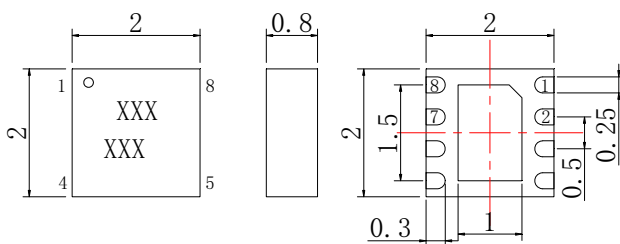
注意事项

1. 器件在干燥、氮气环境中存储。
2. 器件对静电敏感，在运输、储存和使用过程中注意静电防护。
3. 加电时请确认接地良好、电源无冲击。
4. 器件能够适应常规焊接或回流焊工艺。

绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-40°C ~ 85°C
存储温度	-55°C ~ 125°C

封装外形图



序号	对应端口
1	Vb
2	RFin
7	RFout
其他	GND